

平成23年10月31日
ルネサス エレクトロニクス株式会社

平成 24 年 3 月期第 2 四半期決算概要

	当第 2 四半期連結会計期間（3ヶ月） （自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日）		当第 2 四半期連結累計期間（6ヶ月） （自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 9 月 30 日）	
	億円	%	億円	%
売上高	2,433	100.0	4,506	100.0
半導体売上高	2,182		4,022	
その他売上高	252		484	
営業損益	△101	△4.2	△292	△6.5
経常損益	△131	△5.4	△333	△7.4
四半期純損益	△88	△3.6	△420	△9.3
設備投資額	111		250	
減価償却費等	279		556	
研究開発費	464		934	
米ドル為替レート（円）	79		81	
ユーロ為替レート（円）	113		115	

	当第 2 四半期連結会計期間 （平成 23 年 9 月 30 日）
総資産	9,177
純資産	2,379
自己資本	2,302
自己資本比率（%）	25.1
有利子負債	2,656

（注）①億円未満を四捨五入して表示しております。

②本四半期決算概要に記載された平成24年3月期第2四半期の連結財務情報につきましては、会計監査人による四半期レビューが終了していません。今後、会計監査人による四半期レビューまたは後発事象等により数値に変更が生じる場合があります。その場合は、速やかに訂正のプレスリリースをいたします。

③設備投資額は、有形固定資産（生産設備）の発注額を表示しております。

④減価償却費等は、キャッシュ・フロー計算書上の減価償却費と長期前払費用償却額を合算した金額を表示しております。



平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年10月31日

上場会社名 ルネサス エレクトロニクス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6723 URL http://japan.renesas.com/
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)赤尾 泰
 問合せ先責任者 (役職名)コーポレートコミュニケーション部長 (氏名)遠藤 泰三 (TEL)03(6756)5552
 四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満四捨五入)

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	450,576	△23.3	△29,203	-	△33,335	-	△42,011	-
23年3月期第2四半期	587,468	-	729	-	△7,802	-	△41,241	-

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 △53,148百万円(-%) 23年3月期第2四半期 △50,111百万円(-%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第2四半期	△100 72	-
23年3月期第2四半期	△98 87	-

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	917,723	237,868	25.1
23年3月期	1,145,048	291,058	24.8

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 230,203百万円 23年3月期 283,757百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	-	0 00	-	0 00	0 00
24年3月期	-	0 00	-	-	-
24年3月期(予想)	-	-	-	0 00	0 00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	968,000	△14.9	△28,000	-	△37,000	-	△40,000	-	△95 90

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

詳細は、添付資料P. 6をご参照下さい。

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
(注) 詳細は、添付資料P. 7をご参照ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

24年3月期2Q	417,124,490株	23年3月期	417,124,490株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

24年3月期2Q	2,548株	23年3月期	2,548株
----------	--------	--------	--------

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

24年3月期2Q	417,121,942株	23年3月期2Q	417,121,942株
----------	--------------	----------	--------------

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本四半期決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は今後の様々な要因の変化により大きく乖離する可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	5
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	6
2. サマリー情報(その他)に関する事項	7
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	7
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	7
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	7
3. 四半期連結財務諸表等	8
(1) 四半期連結貸借対照表	8
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	10
(第2四半期連結累計期間)	
四半期連結損益計算書	10
四半期連結包括利益計算書	12
(第2四半期連結会計期間)	
四半期連結損益計算書	13
四半期連結包括利益計算書	14
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	15
(4) 継続企業の前提に関する注記	17
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	17

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

1. 当第2四半期連結累計期間（平成23年4月1日～平成23年9月30日）の連結業績

(単位：億円)

	前第2四半期 連結累計期間	当第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増(減)	
			絶対値	割合
売上高	5,875	4,506	△1,369	△23.3%
(半導体売上高)	5,250	4,022	△1,228	△23.4%
(その他売上高)	625	484	△142	△22.6%
営業損益	7	△292	△299	—
経常損益	△78	△333	△255	—
四半期純損益	△412	△420	△8	—
米ドル為替レート(円)	90	81	—	—
ユーロ為替レート(円)	116	115	—	—

当第2四半期連結累計期間における連結業績は以下のとおりであります。

(売上高)

当第2四半期連結累計期間の売上高は、前第2四半期連結累計期間と比べ23.3%減少し4,506億円となりました。東日本大震災（以下「震災」）により当社グループの生産が一時休止したことに伴う生産減や、世界経済の景気減速による需要減、さらには、前第2四半期連結累計期間と比べ為替レートが円高であったことが、売上減の主な要因であります。また、当第2四半期連結累計期間の半導体売上高については、前第2四半期連結累計期間と比べ23.4%減少し4,022億円となりました。

(営業損益)

当第2四半期連結累計期間の営業損益は292億円の損失で、前第2四半期連結累計期間と比べ299億円の悪化となりました。研究開発費の効率化等により販売費及び一般管理費の削減を進めたものの、売上高が減少したことにより営業損失に転じました。

(経常損益)

当第2四半期連結累計期間の経常損益は333億円の損失となりました。支払利息などの営業外費用を55億円計上した結果、営業外損益が41億円の損失となったことによるものです。

(四半期純損益)

当第2四半期連結累計期間の四半期純損益は420億円の損失となりました。災害による損失を含む特別損失を176億円計上したことなどによるものです。

2. 当第2四半期連結会計期間（平成23年7月1日～平成23年9月30日）の連結業績

(単位：億円)

	前第2四半期 連結会計期間	当第2四半期 連結会計期間	前年同期比 増(減)	
売上高	2,954	2,433	△521	△17.6%
(半導体売上高)	2,635	2,182	△453	△17.2%
(その他売上高)	319	252	△68	△21.2%
営業損益	11	△101	△112	—
経常損益	△43	△131	△88	—
四半期純損益	△82	△88	△6	—
米ドル為替レート(円)	88	79	—	—
ユーロ為替レート(円)	111	113	—	—

当第2四半期連結会計期間（以下「当第2四半期」）の世界経済は、欧州の財政・金融不安の深刻化、米国債の格下げ、先進国における失業率の高止まりに加え、経済成長を支えていたアジア圏を中心とする新興国においても成長鈍化の傾向がみられるなど、先行き不透明感が高まりました。また、日本経済においても、震災からの復興に伴い回復基調となったものの、世界経済の景気減速や、円高傾向の継続などにより、期の後半にかけて回復のペースは緩やかになりました。

こうした経済環境の下、当社グループの主力事業領域である半導体市場においては、震災からの生産復旧などにより国内市場について需要の回復がみられたものの、歳末商戦に向けた半導体需要の盛り上がりは殆どみられず、市場を牽引してきた新興国市場向けの半導体需要についても、景気の先行き不透明感などから期の後半にかけてかげりがみられる状況となりました。

当第2四半期における連結業績は以下のとおりであります。

(売上高)

当第2四半期の売上高は、前第2四半期連結会計期間（以下「前第2四半期」）と比べ17.6%減少し2,433億円となりました。震災の影響による当社グループの生産減があったことや、世界的な景気減速に伴い前第2四半期と比べ電子機器需要全般が落ち込んだことによる需要減、さらには、対米ドルにおいて為替レートが円高であったことなどが、売上減の主な要因であります。

(半導体売上高)

当第2四半期の半導体売上高は、前第2四半期と比べ17.2%減少し2,182億円となりました。当社グループの主要な事業内容である「マイコン」、「アナログ&パワー半導体」、「S o C（システム・オン・チップ）」という3つの製品群、および3つの製品群に属さない「その他半導体」の各売上高は、以下のとおりであります。

<マイコン事業>：875億円

マイコン事業には、主に自動車向けや産業機器向けマイクロコントローラ、デジタル家電や白物家電、ゲームなどの民生用電子機器向けマイクロコントローラ、パソコン、ハードディスクドライブなどのパソコン周辺機器向けマイクロコントローラが含まれております。

当第2四半期におけるマイコン事業の売上高は、前第2四半期と比べ8.8%減少し875億円となりました。主にパソコン周辺機器向けマイクロコントローラや民生用電子機器向けマイクロコントローラの売上が減少したことによるものです。

<アナログ&パワー半導体事業>：672億円

アナログ&パワー半導体事業には、主に自動車、産業機器、パソコンおよびパソコン周辺機器、民生用電子機器向けの、パワーMOSFET、ミックスドシグナルIC、IGBT、ダイオード、小信号トランジスタ、表示ドライバIC、光・高周波などの化合物半導体が含まれております。

当第2四半期におけるアナログ&パワー半導体事業の売上高は、前第2四半期と比べ19.5%減少し672億円となりました。主にパソコンおよび液晶テレビ向け表示ドライバICや民生用電子機器向けアナログICやディスクリートの売上が減少したことによるものです。

<SoC事業>：632億円

SoC事業には、主に携帯端末向け半導体、ネットワーク機器向け半導体、産業機器向け半導体、パソコン、ハードディスクドライブやUSBなどのパソコン周辺機器向け半導体、デジタル家電やゲームなどの民生用電子機器向け半導体、カーナビゲーションなどの自動車向け半導体が含まれております。

当第2四半期におけるSoC事業の売上高は、前第2四半期と比べ24.0%減少し632億円となりました。主に民生用電子機器向けや携帯端末向け半導体の売上が減少したことによるものです。

<その他半導体事業>：3億円

その他半導体事業には、主に受託生産やロイヤルティ収入が含まれております。

当第2四半期におけるその他半導体事業の売上高は、前第2四半期と比べ62.3%減少し3億円となりました。

(その他売上高)

当第2四半期のその他売上高は、前第2四半期と比べ21.2%減少し252億円となりました。

その他売上高には、当社の販売子会社が行っている半導体以外の製品の販売事業、当社の設計および生産子会社が行っている半導体の受託開発、受託生産などが含まれております。

(営業損益)

当第2四半期の営業損益は101億円の損失で、前第2四半期と比べ112億円の悪化となりました。研究開発費の効率化等による販売費及び一般管理費の削減を進めたものの、売上高が減少したことなどによるものです。

(経常損益)

当第2四半期の経常損益は131億円の損失となりました。支払利息などの営業外費用を36億円計上した結果、営業外損益が30億円の損失となったことによるものです。

(四半期純損益)

当第2四半期の四半期純損益は88億円の損失となりました。減損損失や事業構造改善費用を含む特別損失を57億円計上したものの、災害損失引当金戻入額を含む特別利益を116億円計上したことにより、特別損益は58億円の利益となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

1. 資産、負債および純資産の状況

(単位：億円)

	当第1四半期 連結会計期間 (平成23年6月30日)	当第2四半期 連結会計期間 (平成23年9月30日)	前四半期比 増(減)
総資産	9,374	9,177	△197
純資産	2,558	2,379	△179
自己資本	2,481	2,302	△179
自己資本比率(%)	26.5	25.1	△1.4
有利子負債	2,665	2,656	△9
D/Eレシオ(倍)	1.07	1.15	0.08

当第2四半期の総資産は9,177億円で、当第1四半期連結会計期間（以下「当第1四半期」）と比べ197億円の減少となりました。これは、当第2四半期において、現金及び現金同等物や有形固定資産が減少したことなどによるものです。純資産は2,379億円で、当第1四半期と比べ179億円の減少となりました。これは、当第2四半期において四半期純損失を計上したことや、円高に伴う為替調整勘定の悪化などによるものです。

自己資本は、当第1四半期と比べ179億円減少し、自己資本比率は25.1%となりました。また、有利子負債は、当第1四半期と比べ9億円の減少となりました。これらの結果、D/Eレシオは1.15倍となり、当第1四半期に比べ0.08ポイント上昇しました。

2. キャッシュ・フローの状況

(単位：億円)

	前第2四半期 連結会計期間	当第2四半期 連結会計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	350	80
投資活動によるキャッシュ・フロー	△184	△178
フリー・キャッシュ・フロー	166	△97
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24	△32
現金及び現金同等物の期首残高	3,186	1,770
現金及び現金同等物の期末残高	3,318	1,583

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上増に伴い売掛金が増加したことや、税金等調整前四半期純損失を計上したものの、減価償却費を250億円計上したほか震災に関連する保険金の受取額を100億円計上したことなどにより、80億円の収入となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が158億円であったことなどにより、178億円の支出となりました。

この結果、当第2四半期におけるフリー・キャッシュ・フローは97億円の支出となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、32億円の支出となりました。

現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、当第2四半期首残高と比べ187億円減少し、1,583億円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年3月期通期の連結業績見通しについて、売上高は前回予想と比べ510億円の減少となる9,680億円、半導体売上高は同370億円の減少となる8,710億円を見込んでおります。営業損益は280億円の損失、経常損益は370億円の損失、当期純損益は400億円の損失を見込んでおり、各損益につきましては、前回予想（2011年8月2日公表値）からの変更はありません。

当社の主力事業である半導体売上高については、世界経済の景気減速や為替相場における円高傾向の継続などにより、前述のとおり前回予想を下回る見込みであるものの、当上期(平成23年4月～平成23年9月)から当下期(平成23年10月～平成24年3月)にかけては、当社グループの生産供給体制が震災前の水準へ回復することに加えて、当上期における震災影響による生産調整のリカバリに伴う需要増が見込まれることなどから約17%の増収を見込んでおります。マイコン、アナログ&パワー半導体、S o Cの3つの製品群における当下期の見通しは以下のとおりとなっております。

マイコン事業については、自動車向けマイクロコントローラを中心に当上期の生産調整のリカバリによる需要増が見込まれることなどから、当下期においては当上期比で20%台半ばの増収を見込んでおります。

アナログ&パワー半導体事業については、マイコン事業同様自動車向けを中心に、パワーデバイスやアナログI Cの需要増が見込まれることから、当下期においては当上期比で10%台前半の増収を見込んでおります。

S o C事業については、パソコン周辺機器向けや民生機器向け半導体について市場環境の悪化などによる需要減が見込まれるものの、カーナビゲーションなど自動車向け半導体の需要増が見込まれることから、当下期においては当上期比で10%台前半の増収を見込んでおります。

営業損益については、前回予想と比べ半導体売上高の減少による利益減が見込まれるものの、当下期での営業黒字化に向け、引き続き構造対策の推進や統合シナジーの実現などによる収益性の改善を進めるとともに、設備投資の抑制や研究開発費の効率化、人件費の削減など費用削減施策を実行することにより、通期の営業損益は前回予想を維持いたします。

経常損益、当期純損益についても、前回予想からの変更はありません。

なお、通期連結業績の見通しにあたっては、1米ドル78円（前回予想82円から変更）、1ユーロ105円（同110円から変更）を前提としております。

<平成24年3月期通期連結業績予想>

(単位：百万円)

	売上高	(参考) 半導体売上高	営業損益	経常損益	当期純損益
前回(8/2公表)予想(a)	1,019,000	908,000	△28,000	△37,000	△40,000
今回(10/31公表)予想(b)	968,000	871,000	△28,000	△37,000	△40,000
増減額(b-a)	△51,000	△37,000	—	—	—
増減率(%)	△5.0	△4.1	—	—	—
(ご参考)前期実績 (平成23年3月期)	1,137,898	1,018,865	14,524	1,033	△115,023

当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	170,691	117,159
受取手形及び売掛金	137,346	119,219
有価証券	166,998	41,468
商品及び製品	45,800	48,434
仕掛品	61,193	74,385
原材料及び貯蔵品	16,378	15,774
未収入金	37,966	19,914
その他	5,528	11,849
貸倒引当金	△237	△217
流動資産合計	641,663	447,985
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	119,608	115,234
機械及び装置（純額）	135,706	120,840
車両運搬具及び工具器具備品（純額）	34,152	33,319
土地	35,887	35,126
建設仮勘定	20,947	16,216
有形固定資産合計	346,300	320,735
無形固定資産		
のれん	2,485	2,357
ソフトウェア	28,742	29,913
その他	52,003	48,352
無形固定資産合計	83,230	80,622
投資その他の資産		
投資有価証券	10,635	8,638
長期前払費用	43,096	40,977
その他	20,124	18,766
投資その他の資産合計	73,855	68,381
固定資産合計	503,385	469,738
資産合計	1,145,048	917,723

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	144,944	168,344
1年内償還予定の新株予約権付社債	110,000	—
短期借入金	143,467	151,766
1年内返済予定の長期借入金	44,321	44,706
リース債務	8,176	8,012
未払金	78,250	46,616
未払費用	55,538	48,715
未払法人税等	3,962	4,840
製品保証引当金	590	453
債務保証損失引当金	456	403
事業構造改善引当金	2,239	3,035
偶発損失引当金	399	668
災害損失引当金	46,042	8,223
資産除去債務	404	27
その他	6,474	4,712
流動負債合計	645,262	490,520
固定負債		
長期借入金	58,192	50,525
リース債務	14,073	10,627
退職給付引当金	84,831	83,668
偶発損失引当金	1,163	1,060
資産除去債務	5,426	5,478
その他	45,043	37,977
固定負債合計	208,728	189,335
負債合計	853,990	679,855
純資産の部		
株主資本		
資本金	153,255	153,255
資本剰余金	450,413	450,413
利益剰余金	△297,634	△339,645
自己株式	△11	△11
株主資本合計	306,023	264,012
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△259	△292
為替換算調整勘定	△22,007	△33,517
その他の包括利益累計額合計	△22,266	△33,809
新株予約権	48	26
少数株主持分	7,253	7,639
純資産合計	291,058	237,868
負債純資産合計	1,145,048	917,723

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間
四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
売上高	587,468	450,576
売上原価	389,096	309,800
売上総利益	198,372	140,776
販売費及び一般管理費	197,643	169,979
営業利益又は営業損失(△)	729	△29,203
営業外収益		
受取利息	288	373
受取配当金	32	28
持分法による投資利益	126	87
為替差益	—	100
その他	1,084	793
営業外収益合計	1,530	1,381
営業外費用		
支払利息	1,907	2,018
為替差損	4,056	—
固定資産廃棄損	1,323	1,050
退職給付費用	1,191	1,191
その他	1,584	1,254
営業外費用合計	10,061	5,513
経常利益又は経常損失(△)	△7,802	△33,335
特別利益		
固定資産売却益	527	287
負ののれん発生益	2,159	—
偶発損失引当金戻入額	1,774	—
事業譲渡益	1,192	123
投資有価証券売却益	155	9
災害損失引当金戻入額	—	11,145
関係会社清算益	—	343
関係会社株式売却益	—	11
特別利益合計	5,807	11,918
特別損失		
固定資産売却損	158	24
減損損失	35,344	2,392
災害による損失	—	12,725
事業構造改善費用	530	1,804
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,488	—
投資有価証券評価損	119	663
投資有価証券売却損	—	17
関係会社清算損	—	3
特別損失合計	37,639	17,628

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△39,634	△39,045
法人税等	589	2,421
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△40,223	△41,466
少数株主利益又は少数株主損失(△)	1,018	545
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△41,241	△42,011

四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△40,223	△41,466
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△464	△20
為替換算調整勘定	△9,393	△11,657
持分法適用会社に対する持分相当額	△31	△5
その他の包括利益合計	△9,888	△11,682
四半期包括利益	△50,111	△53,148
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△50,922	△53,554
少数株主に係る四半期包括利益	811	406

第2四半期連結会計期間
四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成23年7月1日 至平成23年9月30日)
売上高	295,433	243,342
売上原価	194,052	167,750
売上総利益	101,381	75,592
販売費及び一般管理費	100,313	85,696
営業利益又は営業損失(△)	1,068	△10,104
営業外収益		
受取利息	131	206
受取配当金	8	10
持分法による投資利益	53	31
その他	621	358
営業外収益合計	813	605
営業外費用		
支払利息	950	1,021
為替差損	2,713	242
固定資産廃棄損	1,030	865
退職給付費用	596	596
その他	867	843
営業外費用合計	6,156	3,567
経常利益又は経常損失(△)	△4,275	△13,066
特別利益		
固定資産売却益	368	61
投資有価証券売却益	21	1
災害損失引当金戻入額	—	11,145
関係会社清算益	—	343
関係会社株式売却益	—	11
特別利益合計	389	11,561
特別損失		
固定資産売却損	152	13
減損損失	2,202	2,384
災害による損失	—	868
事業構造改善費用	488	1,804
投資有価証券評価損	119	657
投資有価証券売却損	—	17
関係会社清算損	—	3
特別損失合計	2,961	5,746
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△6,847	△7,251
法人税等	789	1,297
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△7,636	△8,548
少数株主利益又は少数株主損失(△)	539	245
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△8,175	△8,793

四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成23年7月1日 至平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△7,636	△8,548
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△117	163
為替換算調整勘定	△2,146	△9,529
持分法適用会社に対する持分相当額	△25	4
その他の包括利益合計	△2,288	△9,362
四半期包括利益	△9,924	△17,910
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△10,276	△17,929
少数株主に係る四半期包括利益	352	19

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△39,634	△39,045
減価償却費	54,015	49,967
長期前払費用償却額	5,790	5,638
減損損失	35,344	2,392
負ののれん発生益	△2,159	—
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△338	△787
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)	269	1,262
偶発損失引当金の増減額(△は減少)	△1,790	300
災害損失引当金の増減額(△は減少)	—	△33,542
受取利息及び受取配当金	△320	△401
支払利息	1,907	2,018
持分法による投資損益(△は益)	△126	△87
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)	△36	671
関係会社清算損益(△は益)	—	△340
関係会社株式売却損益(△は益)	—	△11
固定資産売却損益(△は益)	△369	△263
固定資産廃棄損	1,323	1,050
事業譲渡損益(△は益)	△1,192	△123
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,488	—
売上債権の増減額(△は増加)	△4,001	11,274
たな卸資産の増減額(△は増加)	△13,882	△20,293
未収入金の増減額(△は増加)	△2,009	1,247
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,618	24,700
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	7,870	△11,684
その他	1,548	△3,971
小計	42,080	△10,028
利息及び配当金の受取額	355	458
保険金の受取額	—	16,000
利息の支払額	△1,917	△1,953
法人税等の支払額	△3,509	△144
特別退職金の支払額	△145	△20,575
訴訟等関連損失の支払額	△3,890	—
災害損失の支払額	—	△4,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,974	△21,126

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	17	—
有形固定資産の取得による支出	△34,541	△45,927
有形固定資産の売却による収入	1,300	18,421
無形固定資産の取得による支出	△1,829	△6,665
長期前払費用の取得による支出	△1,100	△2,150
投資有価証券の取得による支出	△199	△475
投資有価証券の売却による収入	169	309
関係会社株式の売却による収入	—	173
関係会社の清算による収入	—	939
事業譲渡による収入	3,285	2,538
その他	109	249
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,789	△32,588
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	18,341	8,450
長期借入れによる収入	11,500	2,932
長期借入金の返済による支出	△23,760	△10,200
社債の償還による支出	—	△110,000
株式の発行による収入	134,600	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△3,891	△4,109
割賦債務の返済による支出	△2,454	△5,294
その他	△357	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	133,979	△118,221
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,463	△7,083
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	128,701	△179,018
現金及び現金同等物の期首残高	91,234	337,289
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	111,892	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	331,827	158,271

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

〔将来予測に関する注意〕

本資料に記載されている当社グループの計画、戦略および業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、（１）当社グループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、（２）為替レート（特に米ドルと円との為替レート）の変動、（３）地震、台風、洪水等の自然災害、事故、テロをはじめとした当社グループがコントロールできない事由、（４）市場における当社グループの製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、（５）激しい競争にさらされた市場において当社グループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

<本件に関する問合せ先>

ルネサス エレクトロニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部

〔報道関係〕03-6756-5555(直通) 〔IR関係〕03-6756-5552(直通)